

## 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年3月13日

【会社名】 株式会社RS Technologies

【英訳名】 RS Technologies Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 方 永義

【本店の所在の場所】 東京都品川区大井一丁目47番1号

【電話番号】 03(5709)7685(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 正行

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大井一丁目47番1号

【電話番号】 03(5709)7685(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 正行

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 1,638,727,200円  
(注) 募集金額は、払込金額の総額であります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年3月6日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新株式発行に関し必要な事項が平成30年3月13日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 第一部 証券情報

#### 第1 募集要項

- 1 新規発行株式
- 2 株式募集の方法及び条件
  - (1) 募集の方法
  - (2) 募集の条件
- 4 新規発行による手取金の使途
  - (1) 新規発行による手取金の額
  - (2) 手取金の使途

### 第三部 参照情報

#### 第2 参照書類の補完情報

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

## 第一部【証券情報】

### 第1【募集要項】

#### 1【新規発行株式】

(訂正前)

<前略>

- (注) 2 本募集とは別に、平成30年3月6日(火)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式1,220,000株の新株式発行に係る一般募集(以下「一般募集」という。)を予定しておりますが、その需要状況等を勘案し、242,000株を上限として、一般募集の主幹事証券会社である株式会社SBI証券が当社株主である方永義(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。  
本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が貸株人から借り入れた当社普通株式(以下「借入株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、株式会社SBI証券を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。  
株式会社SBI証券は、借入株式の返還を目的として、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から平成30年4月13日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、株式会社SBI証券の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<中略>

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、平成30年3月13日(火)から平成30年3月15日(木)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、株式会社SBI証券による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、株式会社SBI証券は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

<後略>

(訂正後)

<前略>

- (注) 2 本募集とは別に、平成30年3月6日(火)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式1,220,000株の新株式発行に係る一般募集(以下「一般募集」という。)を行いますが、その需要状況等を勘案した結果、一般募集の主幹事証券会社である株式会社SBI証券が当社株主である方永義(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式242,000株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。  
本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が貸株人から借り入れた当社普通株式(以下「借入株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、株式会社SBI証券を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。  
株式会社SBI証券は、借入株式の返還を目的として、平成30年3月16日(金)から平成30年4月13日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、株式会社SBI証券の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

<中略>

(削除)

<後略>

## 2 【株式募集の方法及び条件】

## (1) 【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	242,000株	1,760,368,500	880,184,250
一般募集			
計(総発行株式)	242,000株	1,760,368,500	880,184,250

(注) 1 前記「1 新規発行株式」(注) 2に記載の通り、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して株式会社SBI証券を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下の通りであります。

割当予定先の氏名又は名称		株式会社SBI証券	
割当株数		242,000株	
払込金額		1,760,368,500円	
割当予定先の内容	住所	東京都港区六本木一丁目6番1号	
	代表者の役職氏名	代表取締役 高村 正人	
	資本の額	48,323百万円	
	事業の内容	金融商品取引業等	
	大株主	SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 100%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数(平成29年12月31日)	
		割当予定先が保有している当社の株式の数(平成29年12月31日)	
	取引関係等	一般募集の主幹事会社	
	人的関係等		
当該株式の保有に関する事項			

&lt; 中略 &gt;

- 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
- 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	242,000株	1,638,727,200	819,363,600
一般募集			
計(総発行株式)	242,000株	1,638,727,200	819,363,600

(注) 1 前記「1 新規発行株式」(注) 2に記載の通り、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して株式会社SBI証券を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下の通りであります。

割当予定先の氏名又は名称		株式会社SBI証券	
割当株数		242,000株	
払込金額		1,638,727,200円	
割当予定先の内容	住所	東京都港区六本木一丁目6番1号	
	代表者の役職氏名	代表取締役 高村 正人	
	資本の額	48,323百万円	
	事業の内容	金融商品取引業等	
	大株主	SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 100%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数(平成29年12月31日)	
		割当予定先が保有している当社の株式の数(平成29年12月31日)	
	取引関係等	一般募集の主幹事会社	
	人的関係等		
当該株式の保有に関する事項			

&lt; 中略 &gt;

- 4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(発行価額の総額)から上記の増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。

(注) 5の全文削除

## (2) 【募集の条件】

(訂正前)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	100株	平成30年4月13日(金)		平成30年4月18日(水)

(注) 1 発行価格及び資本組入額については、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。

2 全株式を株式会社SBI証券に割当て、一般募集は行いません。

3 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払込むものとし、

(訂正後)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
6,771.60	3,385.80	100株	平成30年4月13日(金)		平成30年4月18日(水)

(注) 1 全株式を株式会社SBI証券に割当て、一般募集は行いません。

2 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

3 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に発行価格を払込むものとし、

(注) 1の全文削除及び2、3、4の番号変更

## 4 【新規発行による手取金の使途】

## (1) 【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
1,760,368,500	8,620,000	1,751,748,500

&lt; 中略 &gt;

(注) 3 払込金額の総額は、平成30年2月23日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
1,638,727,200	8,620,000	1,630,107,200

&lt; 中略 &gt;

(注) 3の全文削除

## (2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限1,751,748,500円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額8,821,645,000円と合わせた手取概算額合計上限10,573,393,500円について、当社が中国の合弁会社である北京有研RS半導体科技有限公司へ出資するために調達した借入金の返済資金として4,200,000千円を充当、当社の中国の合弁会社へ増資するための資金として2,800,000千円を充当します。残額の3,573,393千円については、ウェーハ増産に係る設備投資資金として、三本木工場に400,000千円、台湾工場に700,000千円、北京工場に2,473,393千円をそれぞれ充当します。

&lt; 中略 &gt;

(単位：千円)

項 目	予定金額	支払予定時期		
		平成30年12月期	平成31年12月期	平成32年12月期
借入金の返済資金	4,200,000	4,200,000		
中国の合弁会社への出資資金	2,800,000		1,750,000	1,050,000
ウェーハ増産に係る設備投資資金	3,573,393		3,573,393	
調達による充当額合計	10,573,393	4,200,000	5,323,393	1,050,000

上記ウェーハ増産に係る設備投資資金3,573,393千円の内訳は、本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)現在(ただし、既支払額については平成30年1月31日現在)、以下のとおりとなっております。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び完了予定年月	
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了
提出会社	三本木工場 (宮城県大崎市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	400,000		増資資金	平成31年 1月	平成31年 6月
艾爾斯半導體 股份有限公司	台湾工場 (中華民国台南市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	700,000		増資資金	平成31年 1月	平成31年 6月
有研半導体材 料有限公司	北京工場 (中華人民共和 国北京市)	ウェーハ事業	8インチシリコンウェーハ 製造設備	2,473,393		増資資金	平成31年 1月	平成32年 1月

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

上記差引手取概算額上限1,630,107,200円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額8,208,412,000円と合わせた手取概算額合計上限9,838,519,200円について、当社が中国の合弁会社である北京有研RS半導体科技有限公司へ出資するために調達した借入金の返済資金として4,200,000千円を充当、当社の中国の合弁会社へ増資するための資金として2,800,000千円を充当します。残額の2,838,519千円については、ウェーハ増産に係る設備投資資金として、三本木工場に400,000千円、台湾工場に700,000千円、北京工場に1,738,519千円をそれぞれ充当します。

&lt; 中略 &gt;

(単位：千円)

項 目	予定金額	支払予定時期		
		平成30年12月期	平成31年12月期	平成32年12月期
借入金の返済資金	4,200,000	4,200,000		
中国の合弁会社への出資資金	2,800,000		1,750,000	1,050,000
ウェーハ増産に係る設備投資資金	2,838,519		2,838,519	
調達による充当額合計	9,838,519	4,200,000	4,588,519	1,050,000

上記ウェーハ増産に係る設備投資資金2,838,519千円の内訳は、本有価証券届出書提出日(平成30年3月6日)現在(ただし、既支払額については平成30年1月31日現在)、以下のとおりとなっております。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び完了予定年月	
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了
提出会社	三本木工場 (宮城県大崎市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	400,000		増資資金	平成31年 1月	平成31年 6月
艾爾斯半導體 股份有限公司	台湾工場 (中華民国台南市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	700,000		増資資金	平成31年 1月	平成31年 6月
有研半導体材 料有限公司	北京工場 (中華人民共和 国北京市)	ウェーハ事業	8インチシリコンウェーハ 製造設備	1,738,519		増資資金	平成31年 1月	平成32年 1月

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



### 第三部 【参照情報】

#### 第2 【参照書類の補完情報】

(訂正前)

&lt; 前略 &gt;

『設備の新設、除却等の計画』

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定額		着手及び完了予定年月		完成後の増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)	着手	完了	
提出会社	三本木工場 (宮城県大崎市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	400,000		平成31年 1月	平成31年 6月	現状の約10%増
艾爾斯半導體股份有限公司	台湾工場 (中華民国台南市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	700,000		平成31年 1月	平成31年 6月	現状の約30%増
有研半導體材料有限公司	北京工場 (中華人民共和国北京市)	ウェーハ事業	8インチシリコンウェーハ製造設備	9,473,393		平成31年 1月	平成32年 1月	現状の約300%増

&lt; 中略 &gt;

(注) 2 上記の表に関しては、当該有価証券報告書等に記載された『設備の新設、除却等の計画』の当社グループ全体の設備投資計画について記載したものです。なお、有研半導體材料有限公司北京工場への設備投資予定額9,473,393千円に関しては、中国の合併会社である北京有研RS半導體科技有限公司への出資金4,200,000千円、今回の増資によって調達する2,800,000千円(当社の中国の合併会社への増資資金)および2,473,393千円(有研半導體材料有限公司北京工場8インチシリコンウェーハ製造設備投資資金)を充当する予定となっております。

なお、北京有研RS半導體科技有限公司への出資金4,200,000千円につきましては、「第一部 証券情報 第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」の表にも記載の通り、借入金により賄っておりましたが、今回の増資資金により全額返済の予定であります。

(訂正後)

&lt; 前略 &gt;

『設備の新設、除却等の計画』

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定額		着手及び完了予定年月		完成後の増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)	着手	完了	
提出会社	三本木工場 (宮城県大崎市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	400,000		平成31年 1月	平成31年 6月	現状の約10%増
艾爾斯半導體股份有限公司	台湾工場 (中華民国台南市)	ウェーハ事業	12インチリクレイムシリコンウェーハ製造設備	700,000		平成31年 1月	平成31年 6月	現状の約30%増
有研半導體材料有限公司	北京工場 (中華人民共和国北京市)	ウェーハ事業	8インチシリコンウェーハ製造設備	8,738,519		平成31年 1月	平成32年 1月	現状の約300%増

&lt; 中略 &gt;

(注) 2 上記の表に関しては、当該有価証券報告書等に記載された『設備の新設、除却等の計画』の当社グループ全体の設備投資計画について記載したものです。なお、有研半導體材料有限公司北京工場への設備投資予定額8,738,519千円に関しては、中国の合併会社である北京有研RS半導體科技有限公司への出資金4,200,000千円、今回の増資によって調達する2,800,000千円(当社の中国の合併会社への増資資金)および1,738,519千円(有研半導體材料有限公司北京工場8インチシリコンウェーハ製造設備投資資金)を充当する予定となっております。

なお、北京有研RS半導體科技有限公司への出資金4,200,000千円につきましては、「第一部 証券情報 第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」の表にも記載の通り、借入金により賄っておりましたが、今回の増資資金により全額返済の予定であります。